



ANSYS ICEPAK

电子散热软件

姓名：
时间：

目录

1 产品简介

2 优势特色

3 应用价值

4 用户案例

目录

1 产品简介

ANSYS ICEPAK产品简介

- ANSYS Icepak是由世界上著名的CAE供应商ANSYS公司开发的一款专门用于电子产品热设计分析软件。
- 目前在中国，ANSYS Icepak被广泛应用于航空航天、机车牵引、电力电子、医疗器械、电气、汽车电子、各类消费性电子产品等等；具体产品包括：通讯机柜、手机终端、笔记本电脑、LED、变频器、变流器、汽车电池包、电源机箱、IC封装、数据中心、光伏逆变器等等。

2 优势特色

ANSYS ICEPAK的优势

- ANSYS Icepak采用最专业的CFD软件Fluent作为求解器，结果可靠。
- ANSYS Icepak与各类CAD软件（Proe、UG、Catia等等）及EDA（Cadence、Mentor、Zuken等等）有良好的接口，方便用户进行产品的热分析。
- 作为专业的电子散热仿真软件，ANSYS Icepak包含丰富的IC封装库、散热器库、风机库、材料库等等。
- ANSYS Icepak可以与ANSYS旗下的Ansoft、Mechanical实现电、热、结构的多物理场耦合模拟，准确模拟产品的各种可靠性分布。
- 集成在ANSYS Workbench下，易用的参数化和优化功能

3 应用价值

为什么需要ANSYS ICEPAK模拟?

■ 洞悉产品设计内因

- 通过ANSYS Icepak仿真，设计人员能“看”到设备内部任何位置的压力、速度、温度、浓度等变量分布，深刻理解产品的设计是否满足设计目标。

■ 快速改型和优化设计

- 设计早期，对多个“假想”方案进行快速验证和改型
- 设计中期，对备选方案进行细节的优化，确保实现最佳性能
- 设备运行期间，进行故障“数值诊断”和“数值改进”

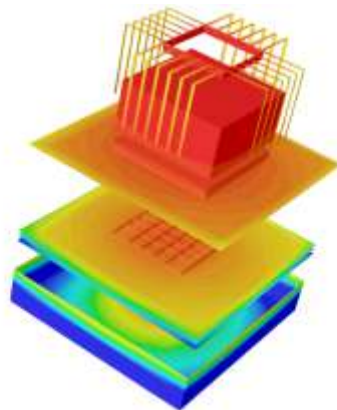
■ 节省费用、时间、能耗……

- 模拟能替代部分实验，节省经费和时间
- 模拟能减少产品设计失败的概率，节省经费和时间
- 模拟能提高产品性能和效率，赢得市场，节省时间和能耗，满足设计规范 and 环保法规等要求

4 用户案例

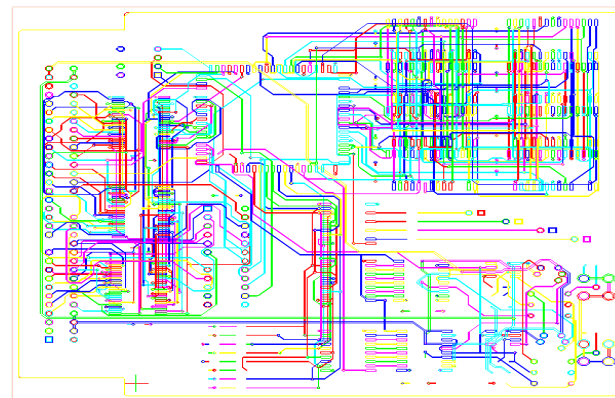
主要应用

■ IC封装



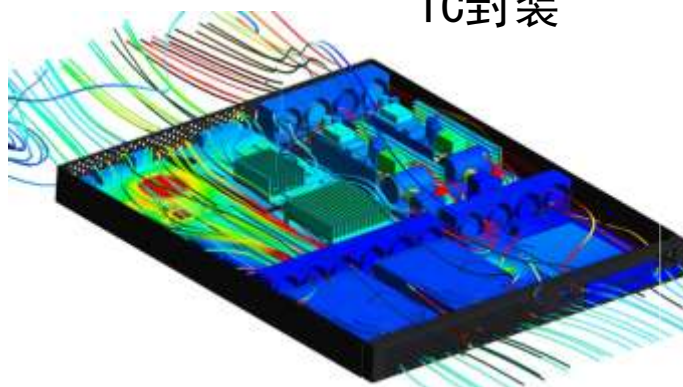
IC封装

■ 板级散热



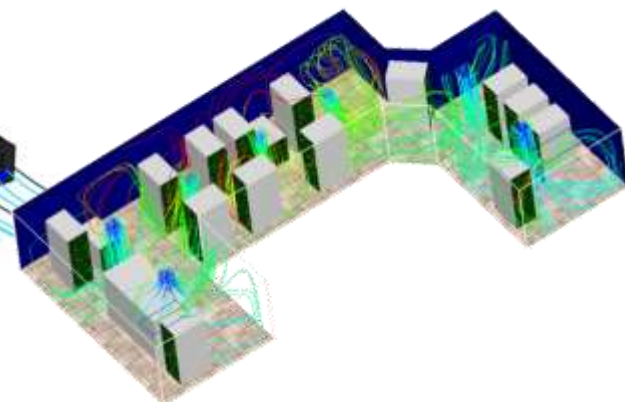
PCB单板

■ 机箱散热



服务器系统

■ 数据中心通风



数据中心

精益研发技术与服务领导者

Thank You

www.peraglobal.com

1996

北京办事处成立

2003

安世亚太科技(北京)有限公司成立

2007

获得美国国际集团
1500万美金投资

2008

推出“精益研发”平台

2009

获得霍英东集团4200万美金投资

2011

十五周年(1996-2011)
安世亚太科技股份有限公司成立

2012